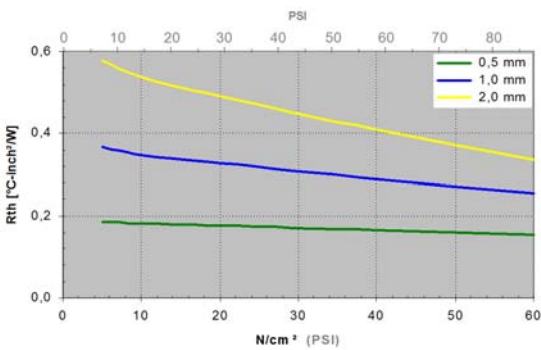




Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	15041
Produktbeschreibung	Einseitig klebender, thermisch leitfähiger Gap-Filler aus Silikon für die thermische Anbindung z.B. von SMD Bauteilen, RDRAM Speicherbausteinen und Flip Chips beispielsweise in Notebooks, Automotiveanwendungen oder in der Medizintechnik
Trägermaterial	Silikon mit Keramikfüllung
Farbe	grau
Materialstärke in mm	1,0
Thermische Eigenschaften	
Thermischer Widerstand @ 400kPa @ Dicke in °C x inch ² /W (mm)	0,3 (0,75)
Thermischer Widerstand @ 200kPa @ Dicke in °C x inch ² /W (mm)	0,32 (0,85)
Thermischer Widerstand @ 70kPa @ Dicke in °C x inch ² /W (mm)	0,36 (0,93)
Thermische Leitfähigkeit in W/mK	5,5
Brennbarkeit UL 94	V0
Betriebstemperaturbereich in °C	-60 bis +180
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsfestigkeit in kV / mm	10
Durchgangswiderstand in Ohm x cm	1,0 x 10 ¹³
Sonstige Merkmale	
	Einseitig klebend
	Außerordentlich weich und formanpassungsfähig
	Extrem alterungs- und chemisch beständig
	Extrem hohe thermische Leitfähigkeit
	Vibrationsdämpfend
	Rückstandslose Entfernung nach Anwendung
 	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

10/17